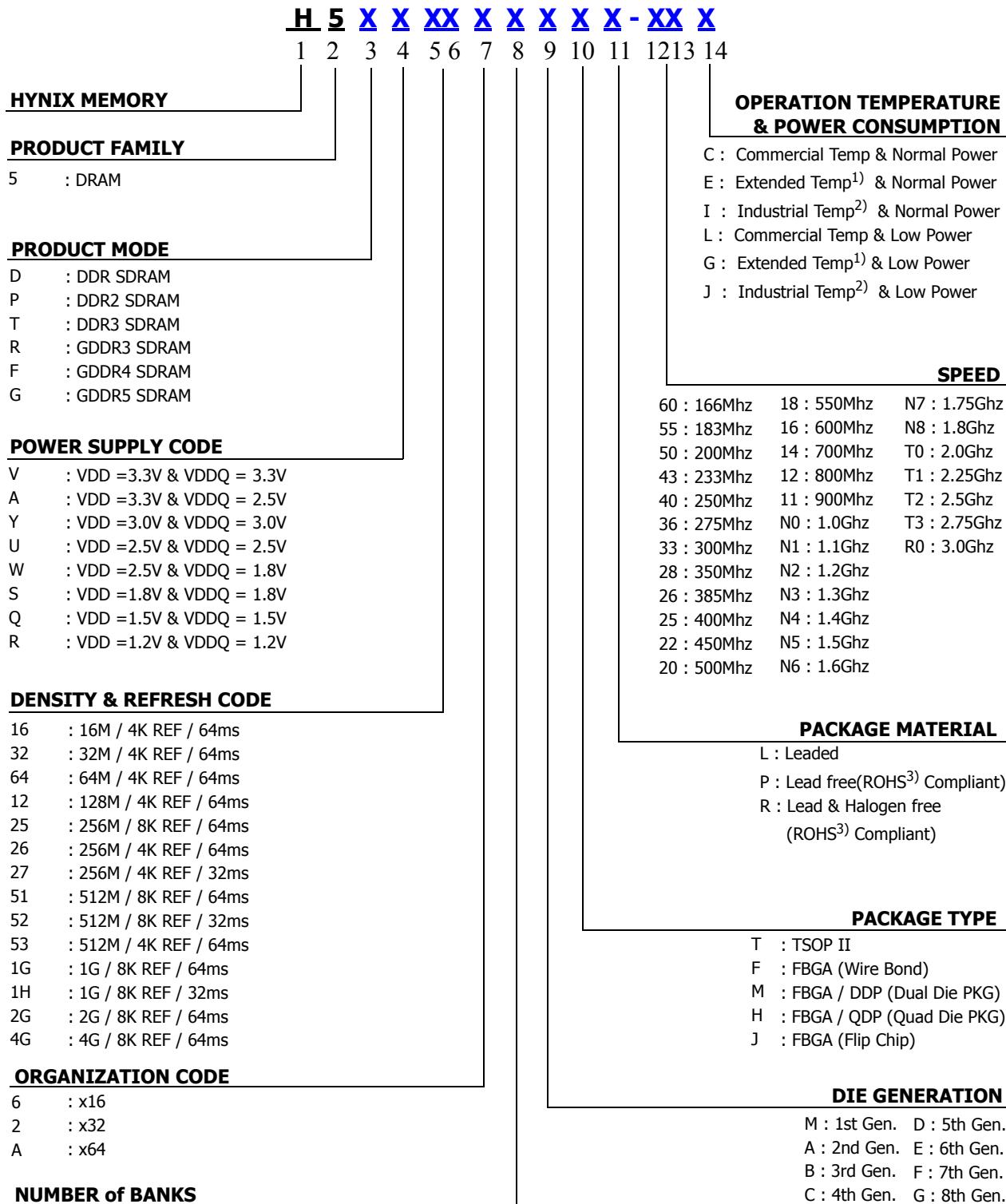


GRAPHICS MEMORY PART NUMBERING



OPERATION TEMPERATURE & POWER CONSUMPTION

- C : Commercial Temp & Normal Power
- E : Extended Temp¹⁾ & Normal Power
- I : Industrial Temp²⁾ & Normal Power
- L : Commercial Temp & Low Power
- G : Extended Temp¹⁾ & Low Power
- J : Industrial Temp²⁾ & Low Power

SPEED

60 : 166Mhz	18 : 550Mhz	N7 : 1.75Ghz
55 : 183Mhz	16 : 600Mhz	N8 : 1.8Ghz
50 : 200Mhz	14 : 700Mhz	T0 : 2.0Ghz
43 : 233Mhz	12 : 800Mhz	T1 : 2.25Ghz
40 : 250Mhz	11 : 900Mhz	T2 : 2.5Ghz
36 : 275Mhz	N0 : 1.0Ghz	T3 : 2.75Ghz
33 : 300Mhz	N1 : 1.1Ghz	R0 : 3.0Ghz
28 : 350Mhz	N2 : 1.2Ghz	
26 : 385Mhz	N3 : 1.3Ghz	
25 : 400Mhz	N4 : 1.4Ghz	
22 : 450Mhz	N5 : 1.5Ghz	
20 : 500Mhz	N6 : 1.6Ghz	

PACKAGE MATERIAL

- L : Leaded
- P : Lead free(ROHS³⁾ Compliant)
- R : Lead & Halogen free (ROHS³⁾ Compliant)

PACKAGE TYPE

- T : TSOP II
- F : FBGA (Wire Bond)
- M : FBGA / DDP (Dual Die PKG)
- H : FBGA / QDP (Quad Die PKG)
- J : FBGA (Flip Chip)

DIE GENERATION

- M : 1st Gen. D : 5th Gen.
- A : 2nd Gen. E : 6th Gen.
- B : 3rd Gen. F : 7th Gen.
- C : 4th Gen. G : 8th Gen.

Note. 1) Extended Temperature: -25°C ~ 85°C

2) Industrial Temperature: -40°C ~ 85°C

3) ROHS (Restriction Of Hazardous Substances) compliant